

2020年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代 表 者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 東証一部)
問 合 せ 先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

シリコンウェーハ用装置の受注について

当社グループは、シリコンウェーハ及び半導体用装置事業の立上げに 2018 年より取組んでおり、この度、中国のお客様等から 300mm ウェーハ用装置を約 10 億円で受注いたしましたのでご報告いたします。

記

5G等の通信技術の進化や、コロナ禍における生活様式の変化、半導体の国産化比率向上を目指す中国政府の支援等を背景に、中国におけるウェーハ用装置の市場は更に成長すると考えられます。

当社は、お客様の要望を丁寧に汲み上げ、解となるアイデアをスムーズに形にすると同時に半導体装置事業の速やかな立上げを狙い、2018年に現地の資本と合弁会社 Z-CSET を設立するなど、様々な取り組みを重ねております。この度の商談においては、本装置の高い生産性等が高く評価され、受注にいたしました。

今後は、本受注を皮切りに中国における半導体装置事業を本格的にスタートさせると共に、中国および国内外のウェーハ製造のお客様に今回の実績を広く訴求し、当社グループの半導体装置事業の更なる拡大を目指します。尚、本装置の受注による今期業績への影響は軽微であり、2022年3月期の業績に寄与する見通しです。

当社グループは、半導体およびディスプレイ装置のリーディングカンパニーとして、大いなる志と溢れる情熱で、世界最高のイノベーションを創造し、社会に貢献する所存です。引続き皆様からの温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上